

尊敬的客户，您好：

随着万网互联、物物互联的 IoT（物联网）时代的到来，降低功耗并控制成本已成为 IoT 市场的关键要素。有鉴于此，国家集成电路设计北京产业化基地（中关村芯园）将于 2017 年 5 月 23 日下午在北京举办“设计与制造技术交流会”第一期，特邀 TSMC、杭州中天、M31 和 eMemory 等公司的技术专家为大家带来低功耗应用方面的技术分享与交流，诚邀您的参加。

一、时间：2017 年 5 月 23 日星期二（PM 13:00 - PM 17:00）

二、地点：北京市海淀区中关村南大街 1 号 1-1 领创空间(友谊宾馆)

三、议程：

会议安排	
1. 签到	13:00—13:30
2. 致欢迎辞	13:30—13:40
3. 中关村芯园平台资源介绍 ——中关村芯园呈献	13:40—13:55
4. TSMC ULP Technology for IOT ——TSMC 呈献	13:55—14:30
5. TSMC eflash solution on ULP technology ——TSMC 呈献	14:30—15:05
6. 抽奖环节	15:05—15:10
7. 基于 IoT 应用的中天嵌入式 CPU 创新解决方案 ——C-SKY 呈献	15:10—15:45
8. Ultra-Low Power IP Solutions for IoT ——M31 呈献	15:45—16:20
9. eMemory' s Trustworthy NVM solutions in TSMC platforms ——eMemory 呈献	16:20—16:55
10. 抽奖环节	16:55—17:00

四、参会说明：

1. 邀请参加（不收费），请带两张本人名片签到。
2. 本次会议的抽奖环节将会有 ipadmin、Kindle、智能手表等重磅大礼等着您。
3. 联系人：刘婷
4. 座机：010 - 82484520 - 822
5. 拟参加人员请将填写报名回执（见附件或下表），回复邮件至 pub@zgcicc.com。

姓名		公司	
手机		电话	
职务		Email	